



報名表

2008/11/27-28, 新竹國賓大飯店

— A Joint Symposium with "e-Manufacturing & DFM Symposium 2008" —

參加者資料

Attendee no:

中文姓名

英文姓名

公司名稱

公司住址

部門

職稱

電話

傳真

電郵位址

會員 非會員 學生 論文發表者

素食

個人資料隱私權注意事項

請注意，您在本報名表所填之個人資料包括(1)姓名，(2)公司或組織名稱，及(3)電子郵件、電話和傳真，將會保存在台灣半導體產業協會 (TSIA) 及 ISMI 的資料庫中，作為 ISMI、TSIA 及其會員公司連絡相關會議資訊之用途。報名表內其他資料將僅作為 TSIA 籌辦本次會議之用途。如果您不願意公開上述個人資料給上述單位，請不要送出本報名表。

報名費		2008.10.27 前報名		2008.10.27 後報名	
會員	個人	NT\$6,000	US\$200	NT\$8,000	US\$260
非會員	個人	NT\$8,000	US\$260	NT\$10,000	US\$320
學生	個人	NT\$5,000 / US\$160			
論文發表者	個人	NT\$5,000 / US\$160			
註	會員意指台灣半導體產業協會之公司或個人會員。屬會員公司之員工視為當然會員。				

- 作者報名費只適用發表論文演講之作者或參加論文展示之一位作者。
- 研討會適用團體報名及優惠；團體報名請利用團體報名表。
- 研討會報名費用包含專題演講、論文發表，下列餐飲及活動；請註明欲參加之活動，以利主辦單位之計畫

Conference Secretariat

Ms. Celia Shih

Tel: +886-3-5917092

Fax: +886-3-5820056

E-mail: celia@itri.org.tw

Rm. 1246, Bldg. 51, 195, Sec. 4. Chung Hsing Rd., Chutung. Hsinchu, 310 Taiwan R.O.C



執行

(a) 11/27 午餐 (b) 11/27 招待酒會 (c) 11/28 午餐 (d) 11/28 晚宴

付款方式：

- (1) 郵局匯票或支票：
抬頭：中華民國台灣半導體產業協會，郵寄至新竹縣竹東鎮中興路四段195號51館1246室，
中華民國台灣半導體產業協會黃佳淑小姐收
- (2) 銀行電匯：
受款人：中華民國台灣半導體產業協會；銀行帳號：016-001-03685-1；
受款銀行：台灣土地銀行 新竹分行
(註明： 公司名稱+AECAPC 2008)
- (3) ATM 轉帳：
受款銀行：台灣土地銀行代號005；帳號：016-001-03685-1(請將匯款收據影本傳真至03-5820056
黃佳淑小姐 以核帳)

請將報名表 e-Mail 至: candy@tsia.org.tw 或傳真至 : +886-3-5820056 江珮君小姐
聯絡人: 江珮君小姐 Tel: +886-3-5913181

Conference Secretariat

Ms. Celia Shih

Tel: +886-3-5917092

Fax: +886-3-5820056

E-mail: celia@itri.org.tw

Rm. 1246, Bldg. 51, 195, Sec. 4. Chung Hsing Rd., Chutung. Hsinchu, 310 Taiwan R.O.C